

# 晶圆导电银胶，IC封装导电银胶

产品名称	晶圆导电银胶，IC封装导电银胶
公司名称	深圳市聚芯源新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区A8栋101
联系电话	13537566612 18028708139

## 产品详情

半导体封装用导电银胶，烧结银和机理

导电银胶是一种固化后可以导电，导热的胶粘剂。相比于传统的焊料:

1 无铅环境友好，固化温度低，特别适合热敏材料粘接，同时作业简单

2 基体是高分子材料，具有良好的柔性和抗疲劳性，自身密度低，更适合现代微电子产业发展趋势。

## 1. 导电胶分类：

可分为各向同性导电胶(ICA,所有方向导电)与各向异性导电胶(ACA,在Z方向导电)两大类

### 一 导电银胶的分类方法：

1 按照导电方向分为：各向同性导电胶和各向异性导电胶。

ICA是指全方位导电的粘合剂，可广泛应用于各种电子领域，比如SMD上的芯片贴装和导电键合。；  
异方性导电胶是指在方向（例如Z方向）导电但在X和Y方向不导电的粘合剂。  
各向异性导电胶（ACA）具有微米级的特殊导电颗粒，使其仅在一个方向上导电。这种类型的胶水通常用于许多电路板上的敏感结构，例如LCD的连接，FPC的粘合，或RFID中天线结构的粘合。